

国泰海通证券股份有限公司

关于

深圳市华科精密工业股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年六月

国泰海通证券股份有限公司

关于深圳市华科精密工业股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书

深圳证券交易所：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“国泰海通”）接受深圳市华科精密工业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华科精密”）的委托，担任华科精密首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，并指定王俊虎、戚务锋作为具体负责推荐的保荐代表人。

保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第2号——上市保荐书内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》（以下简称“《创业板上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《深圳市华科精密工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。

目 录

目 录.....	2
一、发行人基本情况.....	3
二、发行人本次发行情况.....	24
三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.....	24
四、保荐人与发行人的关联关系.....	25
五、保荐人承诺事项.....	25
六、本次证券发行履行的决策程序.....	27
七、保荐人关于发行人符合创业板定位及国家产业政策的说明及核查情况	27
八、保荐人关于发行人符合创业板上市条件的说明.....	32
九、保荐人对发行人持续督导工作的安排.....	36
十、保荐人对本次发行上市的推荐结论.....	37

一、发行人基本情况

（一）基本信息

公司名称	深圳市华科精密工业股份有限公司
英文名称	HOKY PRECISION INDUSTRY CO., LTD.
注册资本	6,857.61 万元人民币
法定代表人	刘学文
有限公司成立日期	2006 年 11 月 16 日
股份公司成立日期	2025 年 12 月 8 日
住所	深圳市宝安区新桥街道象山社区新桥横岗下工业区横岗下大街 14 号一层至三层
邮政编码	518104
电话	0755-27255088
传真	0755-27255088
互联网网址	www.szhoky.com
电子信箱	hokydongmiban@szhoky.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会秘书办公室
信息披露负责人	陈焕奕
信息披露负责人联系电话	0755-29958689

（二）主营业务

公司专注于连接器领域，主要从事电子连接器组件的研发、生产和销售，主要产品包括电信号连接器组件、电源连接器组件以及精密结构件等。

自 2006 年设立以来，公司深耕高速互连领域近 20 年，紧跟国内外移动通信技术从 2G、3G、4G 快速发展到 5G 通信以及 AI 算力技术快速发展的行业要求，不断创新开发，持续迭代为客户提供行业领先的“高速率、高密度、高可靠”的高速互连领域电信号连接器组件产品。在高速率方面，公司电信号连接器组件产品可支持的传输速率创新迭代得越来越高，从早期 3.125Gbps 迭代发展到目前的 224Gbps，其中满足 224Gbps 传输速率要求的电信号连接器组件产品系公司在 2024 年量产供货，使得公司成为行业内最早实现量产供货满足 224Gbps 传输速率要求的电信号连接器组件产品的境内厂商之一；公司满足 448Gbps 传输速率要求的电信号连接器组件产品已于 2025 年向客户小批量送样验证。在高密度方面，

公司电信号连接器组件产品的间距、材料厚度创新迭代得越来越小，其中间距从早期 2.0mm 迭代发展到目前的 0.4mm，材料厚度从早期 0.3mm 迭代发展到目前的 0.05mm 超薄冲压，以满足连接器产品越来越高的高密度微型化要求。在高可靠性方面，公司电信号连接器组件产品的精度创新迭代得越来越高，关键尺寸公差从早期 $\pm 0.02\text{mm}$ 迭代发展到目前的 $\pm 0.005\text{mm}$ ，以满足连接器产品越来越高的信号完整性要求。此外，在电信号连接器组件产品为主的业务基础上，公司基于技术工艺协同，围绕客户需求积极开发精密结构件产品以及满足大电流连接的电源连接器组件产品，丰富了主营业务产品构成。其中，电源连接器组件产品最高可支持 1000A 的直流大电流，主要应用于 AI 算力设备，逐步发展成为公司业务的重要构成。

在深耕高速互连领域和丰富的产品结构基础上，公司建立了优秀的行业技术口碑，在通信、消费电子以及汽车等领域积累了丰富的客户资源，直接客户主要为全球知名的连接器厂商。在通信领域，公司产品主要包括电信号连接器组件、电源连接器组件等，主要应用在 AI 算力中心设备架构中高速互连以及电源连接环节，直接客户主要包括安费诺、立讯精密等知名连接器厂商，下游主要应用于英伟达、亚马逊等厂商的 AI 算力设备，可支持 AI 算力系统以太网/IB 等网络 800G、1.6T 的传输速度。在全球 AI 算力技术和投资快速发展的背景下，公司发展成为 AI 算力领域高速电信号连接器（112Gbps/224Gbps）组件领先的境内厂商之一。在消费电子领域，公司产品主要包括电信号连接器组件、精密结构件等，主要应用于手机、平板等消费电子产品内外部连接以及结构支撑等，直接客户主要包括安费诺、立讯精密、广瀚电机、信维通信等知名连接器或消费电子零部件厂商。在汽车领域，公司产品主要包括电信号连接器组件、电源连接器组件等，主要应用于新能源汽车的智能化以及电动化等模块，直接客户主要包括安费诺、罗森伯格等知名连接器厂商。公司与主要客户建立了稳定的合作关系，连续多年被评为安费诺、立讯精密的优秀供应商。

公司产品持续获得行业知名连接器厂商认可，并且客户群体不断丰富，系源于公司在专注精密冲压、精密注塑等精密工业技术积累的基础上，围绕研发创新、精密模具设计开发、精密制造等竞争优势方面长期积累形成的产品持续创新迭代的能力以及高品质低成本、规模化及时交付的综合服务能力。公司是国家级高新

技术企业，先后被认定为“省级创新型中小企业”、“省级专精特新中小企业”，并被评为“广东省先进级智能工厂”，并参与起草《真空技术夹紧型快卸连接器尺寸（GB/T 4982-2025）》国家标准，积累形成了 13 项具有自主知识产权的核心技术，铸就形成产品持续创新迭代的能力以及高品质低成本、规模化及时交付的综合服务能力。截至 2025 年 12 月 31 日，公司取得授权专利 50 项，其中发明专利 21 项。

（三）发行人的核心技术

1. 核心技术概况

公司研发活动始终围绕客户需求及市场发展趋势进行，以实现技术产业化为目的。公司通过持续的研发投入和技术创新，形成了 13 项具有自主知识产权的核心技术，涵盖模具设计、精密冲压、精密注塑等领域，与主营业务产品密切相关。公司主要核心技术如下：

序号	核心技术名称	技术保护措施	技术来源	所处阶段
1	高速电信号连接器信号端子 U 型扭转冲压技术	已授权专利 2 项，1 项专利在审	自主研发	大批量生产
2	224G 高速电信号连接器信号端子尖角触点冲压技术	1 项专利在审	自主研发	大批量生产
3	高速电信号连接器信号端子 PIN 宽与剪切面高精度冲压技术	1 项专利在审	自主研发	大批量生产
4	高精密信号端子 0.5mm 直径细小抽引冲压技术	已授权专利 1 项，1 项专利在审	自主研发	大批量生产
5	高速电信号连接器 Pogo Pin 接触件一体冲压技术	1 项专利在审	自主研发	基础研究
6	连接器高真圆度实心圆 PIN 信号端子冲压成形技术	已授权专利 1 项	自主研发	大批量生产
7	高速电信号连接器轮廓度精密冲压控制技术	已授权专利 1 项，2 项专利在审	自主研发	小批量生产
8	多零件、多材质模内组合铆接技术	已授权专利 2 项，1 项专利在审	自主研发	大批量生产
9	多台阶包圆精密冲压技术	1 项专利在审	自主研发	大批量生产
10	超薄材料连续高速精密冲压技术	已授权专利 2 项	自主研发	大批量生产
11	反向冲裁废料吸出冲压技术	已授权专利 2 项	自主研发	大批量生产

序号	核心技术名称	技术保护措施	技术来源	所处阶段
12	嵌件式多穴薄壁注塑成型技术	已授权专利 2 项，1 项专利在审	自主研发	大批量生产
13	注塑模具滑块微间隙锁紧与动态高精密定位技术	已授权专利 2 项	自主研发	大批量生产

2. 核心技术先进性及具体表征

序号	核心技术名称	行业技术的发展情况	公司技术先进性的具体表现
1	高速电信号连接器信号端子U型扭转冲压技术	高速电信号连接器U型扭转结构信号端子为0.05mm薄料组件，加工难度较大，其传统加工方案为外置伺服马达结合气缸夹持结构扭转的分步方案，存在显著瓶颈：一是在气缸夹持结构负责夹持动作的模式下，夹持动作缺乏模具本体刚性约束，薄料在气缸夹持定位中精度不够，易导致扭转角度失控；二是外置伺服马达负责扭转动力，气缸夹持结构负责夹持动作，两者协同工作的模式制造效率较慢。综上，传统加工方案严重影响产品良率和量产效率。	公司高速电信号连接器信号端子U型扭转冲压技术的实现路径如下：一是将气缸夹持结构创新性地改为导轨滑块模组夹持结构，可以实现0.002mm的夹持间隙，保障了薄料扭转过程中的稳定性；二是摒弃外置伺服马达的驱动方式，通过模具本体集成杠杆结构、齿条传动结构、斜块同步结构及锁止结构等实现一体化扭转成形。通过上述技术，从模具结构上保障了端子尺寸精度，使扭转角度稳定控制在±1°，提升了产品品质稳定性，同时实现了稳定量产，提升了量产效率。
2	224G 高速电信号连接器信号端子尖角触点冲压技术	信号端子是连接器核心导电接触结构，满足224Gbps传输速率的连接器组件精度要求非常高，其形状与尺寸的微小瑕疵将直接影响连接器信号完整性。 在制造工艺上，传统工艺采用先成形再下料的方式，容易导致尖角塌陷和不对称问题；在模具加工方面，因为传统模具结构设计为一体式异形零件结构，所以只能采用电火花加工，但电火花加工的精度不足，导致触点尖角易出现尺寸偏差等问题。上述技术短板导致接触区尖角成型效果未达设计标准，引发阻抗不匹配、信号衰减等质量问题，成为制约高速电信号连接器组件生产制造的关键瓶颈。	公司224Gbps高速电信号连接器信号端子尖角触点冲压技术的技术路径如下： 一是改变传统加工工序，采用先下料再成形的方式，成形工站采用一体式成形结构，摒弃传统仿形下料复杂工序，从而解决尖角不对称难题； 二是在模具结构设计上，将一体式异形零件结构创新性的改为多斜面相交结构，从而使得模具适配光学研磨加工方式，提升模具零件加工精度与表面粗糙度，从而在冲压工艺中提高触点尖角尺寸稳定性。 通过采用该技术，解决了传统工艺的信号端子尖角尺寸偏差、成型不规则等问题，实现连接器触点尖角的高精度、高一致性成形，显著提升产品性能。
3	高速电信号连接器信号端子PIN宽与剪切面高精度冲压技术	信号端子是高速电信号连接器中实现电信号传输、影响各项性能指标的核心部件。随着连接器向高密度微型化发展，要求信号端子PIN宽尺寸越来越小、精度越来越高。传统冲压工艺主要采用跳步粗冲下料方式，易导致以下问题：一是端子的几何形状和PIN宽大小尺寸易精度失控、	公司通过在模具结构、产品加工工序上进行创新，实现路径如下：一是在模具结构方面，创新式采用刺破结构替代跳步下料方式，将端子pin宽极差控制在0.008mm以内，有效解决传统跳步下料工艺中翻料造成的pin宽大小不一和折弯歪斜的问题。二是在加工环节方面，在粗冲下料基础上增加强压成型工序，利用超高压迫使材料发生塑性

序号	核心技术名称	行业技术的发展情况	公司技术先进性的具体表现
		端子塌角过大,进而引发注塑成型时产生漏胶、金属丝压伤等问题,影响端子电气性能;二是端子接触区粗糙度大,影响连接器的特性阻抗稳定性。	流动并消除回弹,从而获得表面光滑、塌角可控的高精度形状。通过本技术有效改善信号端子剪切面质量、PIN 宽精度的稳定性,从而提升特性阻抗稳定性以及信号完整性。
4	高精密信号端子 0.5mm 直径细小抽引冲压技术	直径 0.5mm 高精密信号端子是射频领域使用广泛的核心组件。抽引工艺是其精密制造过程中的重要环节,但在规模化批量生产中常面临以下技术瓶颈:一是在抽引过程中,产品表面易出现晶粒粗大、光洁度不足等问题,极易产生起皱、破裂等缺陷,严重影响产品性能;二是材料在抽引过程中流动性难以控制,导致尺寸与形状精度极难把控,严重影响量产效率。	公司高精密信号端子 0.5mm 直径细小抽引冲压技术的实现路径如下: 一是通过仿真模拟材料在抽引过程中变形状态进而确定模具设计中抽引工位数量,根据模拟结果确定采用多工位、小变形量的连续抽引方式,以低变形量逐级累积延伸,稳定控制材料应变分布,确保拉伸成形质量;二是利用前置导正机构在抽引动作发生前完成材料精确定位,并配合脱料板的反向顶出机构,在一个冲压行程内完成了定位、导正、抽引及脱料的全套动作,有效提升尺寸与形状精度及量产效率。 基于该技术的精密控制能力,公司产品实现了极高的尺寸一致性与稳定性,关键尺寸公差严格控制在$\pm 0.008\text{mm}$以内;同时,高速连续抽引冲压作业,实现了高精度与高效率的统一,满足大规模生产对良率与产能的双重要求。
5	高速电信号连接器 Pogo Pin 接触件一体冲压技术	高速电信号连接器 Pogo Pin 接触件是电信号连接器中广泛应用的核心组件。传统 Pogo Pin 接触件普遍采用分步加工与组装工艺,一是探针采用机加方式完成,二是套筒采用拉伸方式完成,三是探针与套筒通过弹簧组装连接,不仅工序冗长、工艺复杂,更导致了生产成本较高,且难以满足大规模自动化量产对高效率与一致性的严苛要求。	公司高速电信号连接器 Pogo Pin 接触件一体冲压技术的实现路径如下:摒弃了探针、套筒、弹簧分体加工再组装的繁琐流程,采用连续精密冲压技术,将接触件的核心结构一次性冲压成形,实现了从“分体组装”到“结构一体化”的创新。一是在效率提升方面,连续精密冲压实现了材料到成品的连续化生产,省去了传统工艺中多次装夹、转运与组装环节,生产周期大幅缩短,量产效率大幅提升。二是在成本控制方面,一体化成形减少了零部件数量与加工工序,降低了材料损耗与人工成本。三是在性能优化方面,一体冲压成形的接触件结构更加紧凑、精度更高,无组装缝隙的设计有效提升了产品的接触电阻稳定性和机械稳定性。 基于一体冲压工艺,公司实现了高速电信号连接器 Pogo Pin 接触件的产品性能与量产效率的双重提升。

序号	核心技术名称	行业技术的发展情况	公司技术先进性的具体表现
6	连接器高真圆度实心圆 PIN 信号端子冲压成形技术	实心圆 PIN 信号端子是一种特殊结构的高精度电子连接器组件，具有广泛的应用场景，其重要指标是真圆度。 该产品的传统加工工艺为机加工方式，存在工艺成本高、效率低的问题，为降低生产成本和提高生产效率，行业逐步探索采用连续冲压工艺，但该工艺亦存在产品尺寸精度难控、真圆度差、毛刺大等问题。	公司高真圆度实心圆 PIN 信号端子冲压成形技术路径如下：一是在行业通行的连续冲压工艺基础上，采用多工序分步冷镦包圆工艺使材料温和流动逐步成形，从而解决产品尺寸精度难控问题，并有效释放成形应力；二是在冷镦包圆工艺过程中，采用高精度封闭式型腔结构约束，对材料进行整形。 通过本技术，解决了连续冲压工艺下产品尺寸精度难控、真圆度差等问题，实现真圆度尺寸稳定。
7	高速电信号连接器轮廓度精密冲压控制技术	随着数据传输速率从 224Gbps 向 448Gbps 甚至更高速率演进，连接器信号完整性面临着越来越大的挑战，连接器组件的几何精度——特别是轮廓度，是直接决定信号插入损耗、回波损耗以及串扰水平的核心变量。微米级的轮廓偏差都可能导致阻抗失配，进而引发严重的信号反射与衰减。在产品生产过程中面临着以下问题：一是材料在高密度冲切工艺下的强度衰减与应力释放导致的回弹翘曲，是影响产品轮廓度的首要难题。翘曲及其导致的轮廓失真，会直接改变信号传输路径，从而在高速传输中劣化信号质量。二是高速电信号连接器通常需要经过多工位精密折弯成形，折弯工艺中的不对称性及侧向受力不均会导致成形后的应力累积，从而造成连接器接触阻抗波动、物理接触失效。	公司高速电信号连接器轮廓度精密冲压控制技术的解决路径如下：一是利用仿真对高密度冲切过程进行全流程模拟，分析材料流动、剪切断裂带以及剪切后的弹性恢复趋势，提前识别出翘曲风险最高的区域，对该区域采用分散对称冲切布局，避免单次大空位冲切引发的应力不均。二是在模具内设计专门的应力释放工位，通过微变形或局部加压释放冲切过程中积累的应力，防止后工序中因应力释放导致的轮廓度尺寸偏差。三是对于不对称的成形产品增加假体实现对称折弯，平衡侧向力，防止在成形过程中发生侧向扭曲或位移。四是在成形工序后增加具备多向调节能力的反向整形结构，有效消除成形过程中累积的内应力，确保产品关键部位的轮廓度达到高精度要求，实现对翘曲区域的精准定位与校平。 通过本技术，公司成功解决了高速电信号连接器组件因材料回弹翘曲和应力累积引发的轮廓度失控问题，保障了产品的信号完整性。
8	多零件、多材质模内组合铆接技术	电子连接器作为一种高度集成的精密元器件，通常由多个精密组件构成，其中部分相同材质或不同材质的组件需要由组件厂商完成组装集成。在传统的生产工艺中，组件厂商一般通过独立的冲压、注塑或机加工工序分别将各个组件制造成形后，再通过人工或自动化设备进行二次组装，但面临以下缺点：一是传统工艺工序繁琐、生产周期较长，影响量产效率；二是额外的组装工序导致人工或设备投入	公司多零件、多材质的模内组合铆接技术的实现路径如下：一是冲压件与预制件的一体化铆接，精密冲压设备将部分金属带材经冲压成形的同时，将预制的其他微型零件通过模具内部精密机械机构在高速冲压的行程间隙精确地传输、定位到前述冲压成型的基体上，从而在下一个冲程中同步完成铆接，最终形成一个集成了多零件、多材质的组件。二是冲压件相互之间的一体化铆接，精密冲压设备将两个或多个金属料带在同一套模具内冲压成形，在高速冲压的行程间隙通过模具

序号	核心技术名称	行业技术的发展情况	公司技术先进性的具体表现
		增加,使得成本控制面临压力;三是生产过程需要多次流转和装夹,从而导致误差累积,影响产品品质一致性。	内部精密机械机构精确地将副料带组件传输、定位到主料带上,再进行裁切、铆压,实现冲压、装配、铆接等多工序,最终形成一个集成了多零件、多材质的组件。 通过本技术,在一个高度精密的连续冲压模具内将多个制造步骤融为一体,将基材的精密冲压成形与铆接集成同步完成,解决多工序转运与二次定位误差,提高了产品品质和量产效率,降低了产品生产成本。
9	多台阶包圆精密冲压技术	多台阶包圆冲压件具有尺寸精度高、一致性好,屏蔽性能优异的特点,是射频连接的核心零部件。该产品的核心技术难点在于尺寸精度易失控、结构回弹变形及装配定位受限三个方面: 一是在包圆成形的动态过程中,“多台阶”与“包圆”工艺的叠加,导致不同高度的台阶结构易发生空间上的相互干涉,进而使得产品真圆度及台阶高度等关键尺寸难以精准控制; 二是多台阶结构意味着零件表面存在大量的转角与折弯,台阶转角处应力集中,导致产品容易出现折弯开裂,影响屏蔽性能; 三是在多台阶包圆成形过程中,材料流动受多台阶结构的几何约束与摩擦阻力影响,局部区域金属难以充分填充小R角部位,被迫沿阻力更小的大圆弧路径流动,导致小R角处材料填充不充分,进而引发R角尺寸过大与轮廓精度失控。	公司多台阶包圆精密冲压技术的解决路径如下: 一是通过仿真模拟材料在台阶和包圆成形过程中的变形状态,进而在模具设计时精准计算出回弹补偿量,抵消成形过程中的弹性形变,保障产品真圆度及台阶高度等关键尺寸稳定可控; 二是在精密制造工艺上,摒弃传统的少步骤包圆法,采用十余步的“渐进式滚压”包圆工艺,减小单工站变形量,平缓材料转角处的应变路径,分散应力峰值,逐级释放应力,从而解决冲压转角处的应力集中、开裂及模具零件崩角问题; 三是在台阶成形工站,采用预折弯或多次折弯工艺,通过滑块结构对零件外侧R角区域实施反向加压,使外R角区域材料充分填充并形成近尖角轮廓,并通过整形工站对零件台阶面及转角区域施加均匀整形力,强制校正转角外R尺寸,最终实现复杂多台阶结构件的高精度成形,有效解决因R角过大导致的装配定位精度不足问题。 通过本技术,解决了多台阶包圆组件产品尺寸精度易失控及装配定位受限的问题,提高了产品品质的稳定性。
10	超薄材料连续高速精密冲压技术	在电信号连接器高速化、高密度微型化的行业发展趋势下,信号端子结构的微细薄型化已成为实现上述发展趋势的关键技术路径之一。行业内针对信号端子开始采用0.05mm厚度的超薄材料进行连续冲压加工,但面临以下	公司通过采用伺服精准送料技术、微间隙模具优化技术及分段式精控工艺,在模具内完成超薄材定位、冲裁、成形一体化冲压;通过微间隙设计与精准送料的深度配合,从模具结构上保障了高速冲压稳定性,解决了行业核心痛点。

序号	核心技术名称	行业技术的发展情况	公司技术先进性的具体表现
		核心痛点：一是由于材料厚度较薄，其自身刚度不足，传统送料机构采用前置送料方式，易导致在送料传输过程中产生运动干涉与卡滞现象，无法准确进入导正销或模具型腔，严重制约了生产作业的连续性与整体效率； 二是模具间隙设计苛刻，0.05mm 料带的理想冲裁间隙仅为料厚的 3%-5%，即 1.5-2.5 微米，容错空间低，间隙过大会产生毛刺，间隙过小则会出现冲头和刀口崩缺等问题，影响信号端子电气性能和模具零件寿命。	一是通过伺服电机精准控制拉料牵引力与速度，以恒定拉力主动牵引料带行进，替代传统前置送料方式，避免料带拱曲、堆叠、刮擦模面，实现超薄料稳定、平顺、高精度送料，大幅提升送料顺畅度，实现高速稳定生产。 二是模具采用精细化间隙结构设计，关键零件选用超硬质合金材料并配合纳米涂层工艺，从而提升模具零件的硬度和耐磨性，有效降低刀口和冲头崩缺风险。 三是信号端子加工过程中创新性地引入分段式精控工艺，将传统一次性冲裁过程分解为“预切-精切-整形”三个工步，有效稳定控制毛刺，降低信号串扰的风险。 通过本技术，公司在超薄材料冲压方面提升了产品性能稳定性及高速稳定生产的量产效率。
11	反向冲裁废料吸出冲压技术	在高速连接器组件的精密制造领域，工程实践中常需要在以下两种情形中采用反向冲裁工艺，形成“下冲上切”的特殊受力模式：一是冲压工艺中的剪切断裂带必然伴随毛刺产生，但经常要求产品毛刺朝向特定侧以利于后续组装或焊接，因此需要通过模具反向冲裁设计强制实现毛刺朝向非功能面或特定侧；二是在产品几何形状越来越复杂的情形下，下模刀口壁厚往往设计得极薄（如 0.1-0.2mm），高速冲压过程中巨大侧向力与剪切应力，极易导致薄壁刀口发生弹性变形或崩缺。 但在前述反向冲裁工艺中，废料位于脱料板上方，冲裁废料易滞留于脱料板刀口内部，难以通过传统重力或负压方式有效排出，极易引发废料堆积、跳屑及堵刀等故障，进而造成冲压异常、产品压伤甚至威胁模具寿命与产品良率，是当前高速精密冲压亟待解决的关键技术瓶颈。	公司反向冲裁废料吸出冲压技术的实现路径如下：一是创新采用“上段浮动、下段固定”的双段式结构，上段浮动部分通过高精度零件与下段固定基座滑动配合，内置高刚性强力弹簧，形成动态压料系统，不仅提升了冲裁精度，也为废料吸出预留了稳定的气流通路，避免了传统结构中凸模与脱料板间的间隙波动对负压场的干扰。二是对脱料板内的凹模结构进行了创新优化，脱料板内凹模下设刀口、上设中空废料腔，并开设吸废孔与侧置通风接口，同时外接吸风泵形成稳定负压，使废料在冲裁瞬间被吸入腔体并强制排出，实现了“冲裁-吸附-排出”的同步化，杜绝了废料滞留风险。 通过本技术，公司解决了反向冲裁过程中废料滞留问题，保障了连续冲压下的产线稳定运行和产品品质。

序号	核心技术名称	行业技术的发展情况	公司技术先进性的具体表现
12	嵌件式多穴薄壁注塑成型技术	嵌件式多穴薄壁注塑成型技术是当下高速化、高密度微型化连接器组件的核心工艺。嵌件式多穴薄壁注塑成型技术是一种高度集成的精密制造工艺，并非单一技术，而是将嵌件注塑、多穴模具和薄壁注塑三种工艺融合于一体的复杂技术。该工艺的技术难点如下： 一是多穴流动平衡与嵌件导致的流道不平衡冲突，多穴注塑必须实现流动平衡，确保每个型腔生产出的产品重量、尺寸高度一致，但是嵌件会改变流动路径而造成流动不平衡，导致不同型腔之间的填充出现差异。 二是嵌件高精度定位与注塑流动冲击的冲突，嵌件必须被放置在微米级的精确位置上，任何微小的位移都可能导致产品报废或功能失效，但是高温熔体流动容易导致嵌件位置发生偏移，破坏嵌件的精确定位。 三是薄壁高速填充与嵌件低温之间的冲突，为了防止高温熔体在填充过程中过早冷却凝固形成“冻结层”，薄壁注塑必须以极高的射速和压力进行填充，但是高温熔体与常温嵌件接触会产生剧烈热交换，导致嵌件本身受损，同时在嵌件周围的塑胶中产生残余应力，导致产品开裂或翘曲。	公司嵌件式多穴薄壁注塑成型技术的实现路径如下： 一是公司在模具设计阶段，利用专业软件进行仿真，精确预测注塑成型过程，预测并优化流道系统，包括调整浇口位置、增加排气槽或设置微特征引流结构等，实现动态的流动平衡； 二是在模具内设计精密的机械/气动定位销与弹性压紧机构，在合模前将嵌件预固定，合模过程中持续施加稳定压紧力，抵抗熔体冲击，并通过视觉检测在模内进行嵌件预合模检测，确保位置精度控制在$\pm 0.005\text{mm}$； 三是通过模温系统对模具进行预加热，提高嵌件本体温度，延长高温熔体冷却时间，改善填充效果，从而消除残余应力。 通过本技术，公司在实现高效量产和提升产品性能展现了良好的效果，一是发挥多穴模具的规模效应，降低生产成本；二是显著改善产品功能和性能，通过金属与塑料的无缝集成实现导电、导热、连接、定位等多种功能高度集成与产品的小型化。
13	注塑模具滑块微间隙锁紧与动态高精度定位技术	在精密注塑成型领域，模具滑块结构不仅是解决产品侧向倒扣成型的核心机构，也是决定产品精度和滑块寿命的关键变量。模具滑块结构不仅需要“动起来”，更需要在高速、高压的注塑循环中保持恒定微间隙，从而要求具备极高的位置重复精度和稳定性。传统的模具滑块结构普遍采用“斜导柱驱动配合机械楔紧块锁紧”的架构，主要存在以下缺陷： 一是运动精度与重复定位的冲突，在高速动态循环中，模	公司注塑模具滑块微间隙锁紧与动态高精度定位技术的解决路径如下： 一是对模具滑块结构进行创新，将滑动摩擦部位替换为滚珠/滚针导轨滚动摩擦，降低摩擦系数，同时采用预紧式导滑设计，提高滑块与导轨配合面平面度、平行度，有效提升滑块动态重复精准定位；二是对锁紧结构优化，利用楔紧块和定位销双重定位结构产生巨大的垂直分力，将滑块强制压紧在基座上，形成机械自锁，从而防止滑块后退，

序号	核心技术名称	行业技术的发展情况	公司技术先进性的具体表现
		具滑块承受剧烈的交变载荷与惯性冲击，导致其在运动轨迹上产生微小的横向摆动，进而导致滑块重复定位精度较差，无法满足高速化、高密度微型化的连接器产品公差控制在$\pm 0.01\text{mm}$ 以内的需求。 二是高速高压注塑环境下滑块回退与披锋缺陷，高压充填会产生巨大的侧向力，导致滑块发生微量回退，从而在分型面或滑块拼合处形成溢料间隙，直接导致产品产生披锋缺陷。	有效消除高压注塑下的滑块后退量。 通过本技术， 公司实现注塑模具滑块定位精度可稳定在$\pm 0.005\text{mm}$ 以内， 并有效解决因滑块微量退让导致的披锋缺陷， 确保精密注塑的产品品质和量产效率。

（四）发行人研发水平

1. 发行人已取得的专利情况

公司产品持续创新迭代，源于专注精密冲压、精密注塑等精密工业技术的积累，形成了 13 项具有自主知识产权的核心技术，满足行业高速化、高密度微型化等发展趋势。截至 2025 年 12 月 31 日，公司取得授权专利 50 项，其中发明专利 21 项。

2. 重要荣誉或奖项

公司是国家级高新技术企业，先后被认定为“省级创新型中小企业”、“省级专精特新中小企业”，并被评为“广东省先进级智能工厂”，并参与起草《真空技术夹紧型快卸连接器尺寸（GB/T 4982-2025）》国家标准，积累形成了 13 项具有自主知识产权的核心技术，铸就形成产品持续创新迭代的能力以及高品质低成本、规模化及时交付的综合服务能力。

公司产品持续获得行业知名连接器厂商认可，并且客户群体不断丰富，系源于公司在专注精密冲压、精密注塑等精密工业技术积累的基础上，围绕研发创新、精密模具设计开发、精密制造等竞争优势方面长期积累形成的产品持续创新迭代的能力以及高品质低成本、规模化及时交付的综合服务能力。公司与主要客户建立了稳定的合作关系，连续多年被评为安费诺、立讯精密的优秀供应商。

3. 研发项目情况

截至本上市保荐书签署日，公司正在进行的研发项目如下：

序号	项目名称	状态	拟达到的目标
1	用于 AI 算力中心高速传输 448Gbps 32AWG 连接器组件信号针的研发	项目研发	研发适配 448Gbps 架构的 32AWG 连接器信号针，实现高速低损稳定传输，达到高频电气性能与精密机械可靠性，支撑 AI 算力中心高速互连场景规模化应用。
2	用于 AI 算力中心可实现 224Gbps 高速传输 OSFP 铜连接组件的研发	项目研发	研发适配 AI 算力中心的 224Gbps 高速铜连接组件，覆盖 OSFP 全规格，突破高速信号传输技术瓶颈，实现超低损耗、低串扰、高稳定的信号传输，满足算力中心高密度、高可靠高速互连应用，形成可批量落地的成熟技术与产品方案。
3	用于高速信号传输 224Gbps XX 连接器组件	项目研发	研发聚焦 224Gbps 高速信号传输领域，研发 XX 高速连接器组件，通过高频电气设计与精密制造

序号	项目名称	状态	拟达到的目标
	的研发		工艺攻关，实现低损耗、高可靠的高速互连性能，构建满足高端算力需求的可量产核心产品。
4	用于 AI 算力中心高速传输 112Gbps 高速背板连接器组件的研发	项目研发	研发面向 AI 算力中心的 112Gbps 高速背板连接器组件，实现高速率、低损耗、高可靠信号传输，满足高密度部署与长周期稳定运行需求，支撑算力中心高速互连系统应用。
5	用于 AI 算力中心可实现 112Gbps 高速传输的 QSFP /OSFP/MCIO 连接器组件的研发	项目研发	本项目研发面向 AI 算力中心的 112Gbps 高速连接器组件（覆盖 QSFP /OSFP /MCIO 全系列），通过高频电气设计与精密制造工艺攻关，实现低损耗、高可靠的高速互连，满足 800G/1.6T 算力系统的全场景部署需求。
6	用于服务器机柜高速传输 power 连接器高速信号针及其他连机器组件的研发	项目研发	研发高速互连连接器信号针及配套组件，实现高速信号稳定传输与大电流可靠供电，达到高频电气性能及机械环境可靠性要求，支撑服务器机柜规模化应用。
7	高精度车载电信号传输多段式包圆同轴度 0.05mm 端子的研发	项目研发	研发适用于车载高速电信号传输的多段式包圆端子，攻克精密成型关键技术，实现产品同轴度 $\leq 0.05\text{mm}$ ，满足车规级电气性能、机械耐久及环境可靠性要求，形成可规模化生产的完整技术方案。
8	用于汽车射频信号传输多端异性包圆工艺 FAKRA 连接器及信号针的研发	项目研发	研发适用于汽车射频传输的多段异型包圆型 FAKRA 连接器及信号针，实现优异射频传输性能与结构同轴精度，满足车规级可靠性与批量制造要求。
9	用于通讯领域保持位置度稳定且可连续高速成型的连接器组件的研发	项目研发	研发适配通讯领域的连接器组件，实现连续高速自动化成型，并保证组件高精度位置度稳定性与尺寸一致性，满足通讯连接器装配精度与使用可靠性要求，构建高效、高质的端子量产技术方案。
10	用于 AI 服务器大电流电源连接器母线直插互连的研发	项目研发	研发适用于单触点承载 150-1250A 的 AI 服务器大电流传输，用于 48V 直流高压配电机架配电架构，可直接插拔无需精确对准技术方案。
11	用于新能源电池与电芯串联输出至 BDU 接触器的研发	项目研发	研发适用于新能源电池与电芯模组间串联，可实现主正极/主负极输出至 BDU 接触器技术方案。
12	精密模具设计开发技术项目	项目研发	本项目旨在研发高端精密制造用关键模具，通过高精度结构设计与长寿命工艺优化，突破精密成型核心瓶颈，实现产品高一致性、高可靠性生产，构建具备快速量产能力的精密模具开发技术平台。

（五）主要经营和财务数据及指标

项 目	2025.12.31 /2025 年度	2024.12.31 /2024 年度	2023.12.31 /2023 年度
资产总额（万元）	61,507.79	22,712.36	17,856.19
归属于母公司所有者权益（万元）	42,492.36	13,818.70	10,789.35
资产负债率（合并）	30.92%	39.16%	39.58%
营业收入（万元）	47,233.48	23,398.90	19,346.74
净利润（万元）	10,579.47	4,029.35	2,113.91
归属于母公司所有者的净利润（万元）	10,579.47	4,029.35	2,113.91
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	10,550.78	3,980.13	2,068.66
基本每股收益（元）	1.63	0.72	0.38
稀释每股收益（元）	1.61	0.72	0.38
加权平均净资产收益率	54.87%	31.47%	21.72%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	4,002.51	3,405.47	1,724.62
现金分红（万元）	1,250.00	1,000.00	-
研发投入占营业收入的比例	4.50%	4.91%	5.44%

（六）发行人存在的主要风险**1. 与发行人相关的风险****（1）经营风险****①客户集中度较高的风险**

报告期内，公司对主营业务前五名客户的销售收入占主营业务收入的比例合计分别为 94.85%、97.84%和 98.68%，其中公司对主营业务第一大客户安费诺的销售收入占主营业务收入的比例分别为 46.60%、56.02%和 76.29%。公司客户集中度较高主要系由全球 AI 算力领域电子连接器呈现高度集中的市场格局决定的，其中安费诺作为全球连接器市场的头部企业，凭借深厚的技术积淀，在 AI 算力领域连接器的市场占有率位居行业前列。在现有客户集中度较高的情形下，若后续公司未能有效开拓新客户并实现收入转化，并且无法持续维护与现有主要客户的稳定合作关系，将对经营业绩产生重大不利影响。或者若公司的现有主要客户因行业竞争加剧、宏观经济波动等原因导致其市场份额大幅下滑，也可能导致公司订单规模大幅减少，给公司经营带来不利影响。

②产品质量风险

电子连接器组件对连接器产品的电气性能、机械性能和环境性能等三大性能有着直接的影响，因此公司下游客户对组件产品的质量品质提出了很高的要求。公司产品质量控制涉及环节较多，包括模具设计开发、原材料采购、精密冲压、精密注塑、外协生产、产品检测等环节，管理难度较大，容易受到各种不确定因素或无法事先预见因素的影响。随着公司产销规模的快速扩大，不排除由于模具设计开发瑕疵、操作管理不当及其他人为原因等导致公司出现产品质量问题，进而对公司经营造成不利影响。

③经营业绩波动的风险

报告期内，公司主要从事电子连接器组件的研发、生产和销售，主要产品包括电信号连接器组件、电源连接器组件以及精密结构件等。报告期内，公司营业收入分别为 19,346.74 万元、23,398.90 万元和 47,233.48 万元，年均复合增长率为 56.25%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为 2,068.66 万元、3,980.13 万元和 10,550.78 万元，年均复合增长率 125.84%。公司经营业绩与全球 AI 算力设施投资建设的资本开支计划紧密相关，同时也受市场竞争环境、产业政策、管理水平等多种因素的综合影响。若全球 AI 算力投资建设不及预期或发生其他重大不利变化，将导致公司不能持续获得增量订单或公司不能有效拓展市场，引发公司业绩增速放缓甚至业绩下滑，导致产生经营业绩波动的风险。

④外协生产的风险

报告期内，公司生产采用自主生产和外协加工两种方式，其中外协加工主要涉及电镀、镗雕、清洗、热处理等非核心工序。报告期各期，公司外协采购金额分别为 3,861.18 万元、5,205.07 万元和 13,294.72 万元，占原材料采购及外协加工合计采购总额的比例分别为 38.35%、39.36%和 45.49%。若外协厂商出现产品质量问题、产能不足或者因为安全生产、环保等问题受到处罚甚至出现停产等情况，而公司未能及时转移相关产品的外协订单，将可能对公司产品质量、交付能力、经营业绩及品牌形象等产生不利影响。

⑤产能不足的风险

报告期内，公司产销规模持续增加，2025 年公司核心生产工序精密冲压及

精密注塑的产能利用率分别达到 103.57%和 108.98%，产能利用趋于饱和，难以利用现有场地和设备提高产能及产能利用率。公司现有产能瓶颈制约了公司进一步承接大规模订单及拓展新客户的能力。若公司未能及时扩充产能，可能发生因产能不足导致无法及时供货的情况，进而对公司未来业绩增长带来不利影响。

（2）技术风险

①技术研发创新失败的风险

电子连接器高速化、高压化、高密度微型化是行业必然且重要的发展趋势。高速化、高压化和高密度微型化等趋势并非孤立发展，而是相互影响甚至相互融合，使得连接器特别是 AI 算力中心的相关连接器已不是简单的金属触点和塑料外壳相组装，而是电磁学、材料科学、热力学、精密机械的交叉科技产物。同时，公司连接器组件产品的下游客户是行业知名的连接器厂商，对产品性能、成本、交付周期要求极为严苛，使得公司必须在前述行业技术趋势背景下快速响应，积极开展技术研发创新，持续保持产品持续创新迭代能力和高品质低成本、规模化及时交付的综合服务能力。若公司的研发体系不能高效、灵活地响应客户的定制化、快速迭代需求，或在新一代产品的核心技术攻关、工艺验证或量产爬坡过程中遇到重大障碍并落后于竞争对手或客户的时间需求，则公司将可能面临技术研发创新失败的风险，导致客户满意度下降、丧失技术领先优势和市场先机。

②关键技术人才流失的风险

电子连接器行业具有较高的技术壁垒、精密制造壁垒等特征，决定了公司的持续发展高度依赖专业人才培养。一方面，行业的技术特点要求企业配备多学科、并对行业有着深刻理解和经验积累的专业人才；另一方面，在精密制造环节需要企业配备大量的具有丰富生产经验的技术工人。同时，下游行业的快速发展要求上述人员具有较强的学习能力及持续创新迭代的能力。若公司不能构建具有行业竞争力的多维激励体系，则可能面临关键技术人才流失的风险，将对公司持续发展产生负面影响。

（3）财务风险

①毛利率波动的风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 34.17%、38.35%和 42.39%，毛利率

处于较高水平。公司的毛利率受下游应用领域、供需关系、销售策略、成本波动等多方面因素影响。市场竞争加剧及技术快速迭代，或主要原材料价格波动，均将影响产品销售价格和成本，进而影响公司的毛利率水平。若公司无法通过持续创新保持产品竞争力、有效控制成本或优化产品结构，毛利率存在下降风险，并对公司盈利能力产生不利影响。

②存货金额较大的风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 2,713.37 万元、3,685.59 万元和 7,530.08 万元，占流动资产的比例分别为 21.50%、20.20%和 14.19%，存货金额呈逐年增加的趋势。一方面，存货金额较高对公司流动资金占用较大从而可能导致一定的经营风险，特别是出现因产品生产销售周期过长或销售受阻造成存货积压并占用营运资金的情况。另一方面，若未来主要原材料和产品的价格大幅下降，或因产业政策、市场原因等造成客户变更或取消订单计划，则可能造成存货的可变现净值低于账面价值导致存货跌价减值的风险。

③应收账款金额较大的风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 7,993.91 万元、10,441.82 万元和 24,200.40 万元，占各期末流动资产的比例分别为 63.33%、57.22%和 45.60%。随着公司经营规模的扩大，应收账款规模可能继续增长。一方面，较高的应收账款余额会影响公司的资金周转，限制公司业务的快速发展；另一方面，若公司主要客户自身经营状况或财务状况发生恶化、或公司与主要客户的合作关系发生不利变化，将可能导致公司部分应收账款无法按期收回或无法全部收回，对公司的经营现金流产生不利影响。

④税收优惠政策变化的风险

公司为高新技术企业，享受减按 15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。公司现行有效的高新技术企业证书将于 2026 年 12 月到期，若相关证书到期后，公司未能被重新认定为高新技术企业，或国家关于高新技术企业的税收优惠政策发生变化，公司经营业绩将受到一定影响。

（4）内控风险

①经营规模扩张引致的管理风险

报告期内，公司业务规模持续拓展，营业收入不断增大，资产规模也逐步增长。报告期各期末，公司资产总额分别为 17,856.19 万元、22,712.36 万元和 61,507.79 万元。本次发行完成后，随着本次募集资金到位和募集资金投资项目实施后，公司资产、业务和员工规模预计会进一步扩大，对公司战略规划、组织架构、内部控制、运营管理、财务管理、人力资源管理等方面提出了更高的要求。如果公司管理能力与内部控制能力未能进一步有效提升，将使得公司在一定程度上面临经营规模扩张引致的管理风险，包括管理效率降低、运营成本攀升等，对未来业务的发展造成不利影响。

②实际控制人不当控制的风险

本次发行前，公司实际控制人刘学文、钟华夫妻二人合计控制公司 79.68% 的表决权；本次发行完成后，公司的实际控制人不会发生变更。同时，刘学文任公司董事长、总经理，钟华任董事。公司实际控制人可利用对公司的控制及在公司的任职，通过行使表决权、决策权等方式对公司的发展战略、经营决策和人事任免等进行控制。尽管公司建立了各项内部控制制度，从制度安排上可以避免实际控制人不当控制现象的发生，且报告期内也未发生实际控制人损害公司和其他股东利益的情况。若公司相关内部控制制度不能得到有效执行或控制权行使缺乏有效制衡机制，实际控制人利用其控制地位对公司的发展战略、重大决策、生产经营、对外投资等方面实施不当控制，可能产生损害公司及中小股东利益的风险。

（5）法律风险

①部分租赁经营场所产权瑕疵风险

截至本上市保荐书签署日，公司生产经营场所均为租赁使用，其中位于深圳宝安区新桥街道的房产因属于深圳市宝安区农村城市化过程中历史遗留问题处理范围，无法办理土地出让手续，未取得不动产权证书。前述存在产权瑕疵的房产的租赁合同订立至今履行情况正常，但仍存在因城市规划调整或被政府部门依法责令整改等原因导致公司无法正常续租的风险。若未来公司所租赁房产在租赁期限内发生上述情况，将可能导致公司在深圳的生产场所停工、搬迁，对公司的正常经营产生不利影响。

②未能规范运营而被处罚的风险

报告期内，公司及子公司不存在被工商、税务、环保、消防等部门行政处罚等情形。未来随着公司生产经营规模的扩大，可能发生产品质量、安全生产、环保、消防等领域因相应制度未严格执行，出现违法违规行为，从而面临被相关行政机关处罚的风险，可能对公司生产经营产生一定不利影响。

2. 与行业相关的风险

（1）下游行业需求波动风险

公司电信号连接器组件、电源连接器组件以及精密结构件产品的下游应用领域主要包括通信、消费电子、汽车等。近年来，全球通信领域的 AI 算力技术与投资快速发展，带动全球 AI 算力基础设施建设需求大幅提升。公司电信号连接器组件、电源连接器组件产品主要应用于 AI 算力中心设备架构中高速互连以及电源连接环节。受前述全球 AI 算力需求高涨的影响，公司业务发展呈现出持续快速增长态势，但下游行业需求受宏观经济周期、技术迭代速度、产业政策导向及企业资本开支计划等多重因素影响，存在不确定性。若下游行业需求增长放缓或出现阶段性调整，将直接影响公司产品的市场需求，导致订单获取难度增加、销售收入增速放缓甚至下滑，进而对公司的盈利能力与业绩稳定性构成不利影响。

（2）市场竞争加剧风险

电子连接器作为电子、电气领域中的基础元器件，广泛应用于通信及 AI 算力、汽车、消费电子、能源等众多领域。在传统以消费电子、工业控制等为主要应用领域的基础上，受益于新能源汽车、光伏储能、AI 算力等新兴行业的发展，电子连接器的应用领域不断拓展，市场规模获得快速提升。在此背景下，电子连接器及组件行业吸引了众多境内外企业加大投入，可能加剧市场竞争，一方面，境内外连接器厂商积极参与新兴产业领域的竞争，并可能加强对产业链上游组件产研的布局，另一方面，境内连接器组件厂商依托境内产业链条完整、产业配套完善的有利市场环境积极进行技术研发升级，以期抓住连接器创新迭代的产业机遇。行业竞争加剧将推动市场竞争演变为技术迭代、交付及服务、产品价格等多维度综合能力的竞争格局。市场竞争的加剧可能使公司面临市场份额下降、产品

毛利率下滑等方面的不利影响。

（3）高速互连领域技术迭代的风险

公司深耕高速互连领域近 20 年，形成以电信号连接器组件为主的业务架构，主要产品包括 AI 算力、汽车及消费电子等领域的高速电信号连接器组件和电源连接器组件产品。在 AI 算力领域，公司高速电信号连接器组件产品主要应用在 AI 算力中心设备架构中高速互连环节，下游主要应用于英伟达、亚马逊等厂商的 AI 算力设备。目前，背板连接、线缆连接和光连接等三大连接方案在 AI 算力中心投资建设过程中均有大量应用，电信号连接器在其中作为电信号传输的物理载体是不可或缺的关键部件。但全球 AI 算力技术在快速发展，其中的连接架构也在持续迭代升级，若市场出现新的具有巨大优势的高速互连连连接架构或方案，对行业现有厂商而言则会形成技术升级迭代风险。若公司未能准确预判或及时跟进行业技术路线的变革方向，则公司可能错失相应的市场空间，甚至是现有技术及产品面临被替代或淘汰的风险。

（4）主要原材料价格波动的风险

原材料是公司产品成本的重要构成。公司产品涉及的原材料主要包括金属材料、模具材料和塑胶材料等，其中金属材料主要包括磷青铜、铍铜、铬锆铜、铜镍硅合金等高性能合金铜以及不锈钢材料，同时在外协电镀过程中需要使用金、银等贵金属；塑胶材料包括塑料和橡胶等有机高分子材料（LCP、PA、PBT 等）。前述原材料价格主要受国际和国内宏观经济影响，价格波动具有一定的不确定性。若未来前述主要材料的价格持续上涨，而公司无法有效将原材料涨价成本传导至下游客户，也无法通过技术升级、工艺优化等方式抵消成本上涨压力，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。

（5）国际贸易摩擦的风险

报告期内，公司境外销售主要面向北美、欧洲等国家和地区。近年来，全球经济受主要经济体贸易政策变动的影响呈现出较强的不确定性。如果公司主要境外销售国家或地区的贸易政策、监管政策、关税政策等发生重大不利变化，可能对全球经济、产业链竞争格局和连接器行业带来冲击和诸多不确定因素，进而对公司经营业绩造成不利影响。

3. 其他风险

(1) 募投项目风险

①募集资金投资项目新增产能消化的风险

公司本次募集资金主要用于扩大产能、模具加工中心建设、研发中心升级建设以及补充流动资金等。本次募集资金投资项目达产后，公司电子连接器组件的产能将进一步扩大，有助于抓住全球 AI 算力、汽车等领域对连接器需求快速增长的行业机遇。公司募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但该可行性研究系基于当前产业政策、市场环境和发展趋势等因素作出。在公司募集资金投资项目实施过程中，可能面临产业政策变化、市场环境变化等诸多不确定因素，如果市场环境未达预期、发生不利变化、市场开拓不足，或者公司募投项目生产的产品无法满足市场需求，则本次募集资金投资项目新增产能可能面临无法及时消化的风险。

②募投项目新增折旧影响公司盈利能力的风险

本次募集资金投资项目建成后，公司房屋建筑物、机器设备等固定资产的大幅增加将导致年折旧费用上升。由于募集资金投资项目从开始建设到产生效益需要一段时间，在短期内公司不能大幅增加营业收入或提高毛利水平的情况下，新增折旧可能影响公司利润，从而致使公司因折旧大幅增加而存在未来经营业绩下降的风险。

③即期回报被摊薄的风险

本次募集资金到位后，公司总股本和净资产将大幅增加，而募集资金投资项目具有一定的投入周期，在短期内难以完全产生效益，因此，本次募集资金到位后的较短期间内，每股收益及净资产收益率受摊薄影响可能出现下降，从而导致公司存在即期回报被摊薄的风险。

(2) 发行失败的风险

公司本次申请首次公开发行股票并在创业板上市，发行结果可能受到公开发行时国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、投资者对本次发行价格的认可程度、股价未来趋势判断等多种因素的影响，可能存在因发行认购不足等情形导致

发行失败的风险。

二、发行人本次发行情况

股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	不超过 2,310.39 万股	占发行后总股本比例	不低于 25%
其中：发行新股数量	不超过 2,310.39 万股	占发行后总股本比例	不低于 25%
股东公开发售股份数量	-	占发行后总股本比例	-
发行后总股本	不超过 9,168.00 万股		
发行方式	采用网下向投资者配售与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式或监管机构认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者、保荐人依法设立的相关子公司或者实际控制保荐人的证券公司依法设立的其他相关子公司、公司高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划等法律法规允许的投资者配售股票）		
发行对象	符合相关资格规定的询价对象、在深交所开设证券账户并具有创业板交易权限的自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外），证监会或深交所等监管部门另有规定的，按其规定处理		
承销方式	余额包销		
拟上市地点	深圳证券交易所		

三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

（一）本次证券发行的保荐代表人基本情况

国泰海通指定王俊虎、戚务锋作为本次证券发行的保荐代表人。

王俊虎先生：国泰海通投资银行部执行董事，保荐代表人，硕士研究生学历，从事投资银行工作以来主持或参与过的项目包括：苏州富士莱医药股份有限公司首次公开发行股票、华峰化学股份有限公司非公开发行股票、北矿科技股份有限公司非公开发行股票、北矿科技股份有限公司发行股份购买资产、浙江戈尔德智能悬架股份有限公司新三板挂牌、北京智明星通科技股份有限公司新三板挂牌等项目，并曾参与其他多个改制辅导和财务顾问项目。王俊虎先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等有关规定，执业记录良好。

戚务锋先生：国泰海通投资银行部经理，保荐代表人，硕士研究生学历，从事投资银行工作以来主持或参与过的项目包括：昱能科技股份有限公司首次公开

发行股票、华峰化学股份有限公司发行股份购买资产等项目，并曾参与其他多个改制辅导和财务顾问项目。戚务锋先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等有关规定，执业记录良好。

（二）本次证券发行的协办人及项目组其他成员

孙振博先生：国泰海通投资银行部副总裁，硕士研究生学历，从事投资银行工作以来主持或参与过的项目包括：上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产、环旭电子股份有限公司发行股份购买资产等项目，并曾参与其他多个改制辅导和财务顾问项目。孙振博先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等有关规定，执业记录良好。

本次证券发行的项目组其他成员包括：卞加振、杭沁、李宪宇、周韵帆、王小平、姜晓华。

四、保荐人与发行人的关联关系

截至本上市保荐书签署日，保荐人与发行人不存在以下情形：

（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况。

（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系。

五、保荐人承诺事项

（一）保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行

人本次证券发行及上市，并据此出具本上市保荐书。

(二)保荐人通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，保荐人作出以下承诺：

1. 有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

2. 有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3. 有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4. 有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5. 保证所指定的保荐代表人及保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6. 保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7. 保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8. 自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

9. 中国证监会规定的其他事项。

(三) 保荐人及保荐代表人特别承诺：

1. 保荐人与发行人之间不存在其他需披露的关联关系；

2. 保荐人及负责本次证券发行保荐工作的保荐代表人未通过本次证券发行保荐业务谋取任何不正当利益；

3. 负责本次证券发行保荐工作的保荐代表人及其配偶未以任何名义或者方式持有发行人的股份；

4. 保荐人承诺自愿接受深圳证券交易所的自律监管。

六、本次证券发行履行的决策程序

经查验发行人提供的董事会会议资料和股东会会议资料，发行人已就其首次公开发行股票并上市事宜履行了以下决策程序：

发行人于 2026 年 5 月 22 日召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。

发行人于 2026 年 6 月 8 日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。

七、保荐人关于发行人符合创业板定位及国家产业政策的说明及核查情况

（一）发行人符合创业板行业领域要求及国家产业政策

根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第五条规定：“属于上市公司行业分类相关规定中下列行业的企业，原则上不支持其申报在创业板发行上市，但与互联网、大数据、云计算、自动化、人工智能、新能源等新技术、新产业、新业态、新模式深度融合的创新创业企业除外：（一）农林牧渔业；（二）采矿业；（三）酒、饮料和精制茶制造业；（四）纺织业；（五）黑色金属冶炼和压延加工业；（六）电力、热力、燃气及水生产和供应业；（七）建筑业；（八）交通运输、仓储和邮政业；（九）住宿和餐饮业；（十）金融业；（十一）房地产业；（十二）居民服务、修理和其他服务业。禁止产能过剩行业、《产业结构调整指导目录》中的淘汰类行业，以及从事学前教育、学科类培训、类金融业务的企业在创业板发行上市。”

公司主要从事电子连接器组件的研发、生产和销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司所从事的业务属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”项下“C398 电子元件及电子专用材料制造”之“C3989 其他电子元件制造”小类。

根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》和《工业战略性新兴产业

兴产业分类目录（2023）》，公司产品属于“新一代信息技术产业”项下“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”小类，对应《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）“C3989 其他电子元件制造”小类中的重点产品和服务“新型通信设备用连接器及线缆组件”。

根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，公司产品属于“1.新一代信息技术产业”之“1.3 电子核心产业”之“1.3.3 新型元器件”之“新型连接元件”。

综上，公司所属行业不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第五条规定的原则上不支持其申报在创业板发行上市或禁止类行业，因此公司所属行业符合创业板定位。

（二）发行人符合创业板定位相关指标要求

公司符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第四条中第一套指标的要求，具体情况如下：

创业板定位相关标准（一）	是否符合	指标情况
最近三年研发投入复合增长率不低于 15%，最近一年投入金额不低于 1,000 万元	☒ 是 ☐ 否	报告期内，公司研发费用分别为 1,051.96 万元、1,150.00 万元和 2,123.81 万元，最近三年复合增长率为 42.09%，且最后一年（2025 年）研发费用为 2,123.81 万元，超过 1,000 万元
最近三年营业收入复合增长率不低于 25%（最近一年营业收入金额达到 3 亿元的企业，或者按照《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》等相关规则申报创业板的已境外上市红筹企业，不适用前款规定的营业收入复合增长率要求）	☒ 是 ☐ 否	报告期内，公司营业收入分别为 19,346.74 万元、23,398.90 万元和 47,233.48 万元，最近三年复合增长率为 56.25%，且最后一年（2025 年）营业收入为 47,233.48 万元，超过 3 亿元

（三）发行人创新、创造、创意特征及科技创新、模式创新、业态创新情况

1. 表征之一：产品的持续迭代创新

自 2006 年设立以来，公司深耕高速互连领域近 20 年，紧跟国内外移动通信技术从 2G、3G、4G 快速发展到 5G 通信以及 AI 算力技术快速发展的行业要求，不断创新开发，持续迭代为客户提供行业领先的“高速率、高密度、高可靠”的

高速互连领域电信号连接器组件产品。

在高速率方面，公司电信号连接器组件产品可支持的传输速率创新迭代得越来越高，从早期 3.125Gbps 迭代发展到目前的 224Gbps，其中满足 224Gbps 传输速率要求的电信号连接器组件产品系公司在 2024 年量产供货，使得公司成为行业内最早实现量产供货满足 224Gbps 传输速率要求的电信号连接器组件产品的境内厂商之一；公司满足 448Gbps 传输速率要求的电信号连接器组件产品已于 2025 年向客户小批量送样验证。

在高密度方面，公司电信号连接器组件产品的间距、材料厚度创新迭代得越来越小，其中间距从早期 2.0mm 迭代发展到目前的 0.4mm，材料厚度从早期 0.3mm 迭代发展到目前的 0.05mm 超薄冲压，以满足连接器产品越来越高的高密度微型化要求。

在高可靠性方面，公司电信号连接器组件产品的精度创新迭代得越来越高，关键尺寸公差从早期 $\pm 0.02\text{mm}$ 迭代发展到目前的 $\pm 0.005\text{mm}$ ，以满足连接器产品越来越高的信号完整性要求。

2. 表征之二：精密模具的设计开发创新

精密模具设计开发是连接器组件厂商突破技术瓶颈、支撑产品创新迭代的技术基础，也是产品研发创新到生产制造的关键桥梁，直接影响组件产品的性能品质和量产交付效率。公司精密模具设计开发贯穿于组件产品从需求定义到量产落地的全流程，其核心目标是以高品质低成本、规模化及时交付的方式将产品设计转化为具备优良性能和高可靠性的组件产品实体。

公司在精密模具设计开发方面积累了丰富的技术创新经验，形成了较强的竞争优势。一是公司通过专业软件对模具和产品进行仿真验证，能在虚拟环境中精准预测模具以及连接器组件在真实工况下的工艺参数或性能变化，可以高效迭代验证模具和产品设计的可靠性，减少物理试错成本，提高验证成功率。二是公司系统化总结了精密模具设计开发的核心内容，建立模具标准件库以及设计参数化模板，将核心技术难点标准化、模块化、系统化，形成了众多可快速复用的技术规范，可有效降低相似产品模具的设计周期及开发成本。三是在前述基础上，公司拥有对微米级精密冲压、模内铆接、反向冲裁、精密薄壁注塑、嵌件注塑等核

心工艺的深度理解和工艺数据库,能够根据模具设计开发中出现的各项问题及时进行有利于提升产品性能和量产效率的各项创新,包括模具结构设计、模具加工方式、组件精密制造工艺技术等。其中,针对高速电信号连接器信号端子 U 型扭转冲压技术,公司在模具设计开发方面采用了以下创新方案:一是将气缸夹持结构创新性地改为导轨滑块模组夹持结构,可以实现 0.002mm 的夹持间隙,保障了薄料扭转过程中的稳定性;二是摒弃外置伺服马达的驱动方式,通过模具本体集成杠杆结构、齿条传动结构、斜块同步结构及锁止结构等实现一体化扭转成形。通过上述技术,从模具结构上保障了端子尺寸精度,使扭转角度稳定控制在 $\pm 1^\circ$,提升了产品品质稳定性,同时实现了稳定量产,提升了量产效率。

综上,公司优秀的精密模具设计开发创新能力是参与市场竞争并获得客户认可的重要基础。在产品性能方面,在高速化、高压化以及高密度微型化的趋势下,模具设计开发的具体目标是突破性能提升与空间限制的矛盾障碍,实现产品持续创新迭代,满足连接器的优良性能和高可靠性;在量产交付方面,模具设计开发的具体目标是实现高品质低成本、规模化及时交付,助力客户迅速抓住市场机遇并且降低客户的后续筛选成本、售后成本。

3. 表征之三:有效支持 AI 算力新兴产业的发展

AI 算力基础设施的激烈产业竞争,不仅仅是芯片之间的竞争,也包括连接器微型空间内高密度排列的金属触点之间的竞争。

在人工智能(AI)领域的竞争中,算力、数据和算法三者的地位至关重要,其中在 AI 算力方面,全球主要国家在重视 AI 算力技术创新升级的同时,将 AI 算力中心作为新型基础设施加大投资建设力度。AI 算力中心爆发式增长带动了连接器需求数量的迅速增加,同时也对连接器性能提出了更高要求。AI 算力中心以太网/IB 等网络传输速度已经从 25G/50G 增长到 400G/800G 并已经达到 1.6T,对应单通道信号传输速率由 56Gbps 逐渐升级到 112Gbps、224Gbps 并正在向 448Gbps 领域演进。此背景下,连接器传输速率必须相应进行升级迭代,以满足日益严苛的数据传输需求,同时高速率传输对连接器的其他性能也提出了更高要求,尤其是在保障信号完整性方面。因为传输速率成倍提升后,信号衰减和失真的可能性呈指数级增加,连接器微小的阻抗不匹配或串扰等都会导致连接系统无法正常工作,因此在追求高速率的同时必须满足良好的信号完整性要求成为

连接器产品设计与制造的关键难点。为了充分发挥 AI 算力基础设施的硬件效能，突破高速互连瓶颈成为重要技术方式，而高速连接器成为其中的关键突破口之一。因此，高速连接器作为 AI 算力中心系统互连重要节点，深度受益于全球 AI 算力基础设施的需求增长。

在 AI 算力领域，公司产品主要包括电信号连接器组件、电源连接器组件等，主要应用在 AI 算力中心设备架构中高速互连以及电源连接环节，直接客户主要包括安费诺、立讯精密等知名连接器厂商，下游主要应用于英伟达、亚马逊等厂商的 AI 算力设备，可支持 AI 算力中心以太网/IB 等网络 800G、1.6T 的传输速度。在全球 AI 算力技术和投资快速发展的背景下，公司发展成为 AI 算力领域高速电信号连接器（112Gbps/224Gbps）组件领先的境内厂商之一，有效支持了 AI 算力新兴产业的发展。

（四）公司的成长性及其表征

公司主要从事电子连接器组件的研发、生产和销售，主要产品包括电信号连接器组件、电源连接器组件以及精密结构件等，产品主要应用于通信、消费电子以及汽车等领域。凭借在高速互连领域的长期深耕和积累，公司连接器组件产品成功切入 AI 算力产业。

受益于通信领域全球 AI 算力产业爆发式增长的影响，公司营业收入快速增长，体现出良好的成长性。报告期内，公司营业收入分别为 19,346.74 万元、23,398.90 万元和 47,233.48 万元，最近三年复合增长率为 56.25%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为 2,068.66 万元、3,980.13 万元和 10,550.78 万元，年均复合增长率 125.84%。

近年来，随着人工智能（AI）对未来全球经济、科技等众多领域的重要意义日益上升，AI 竞争已成为市场、科技竞争的热点领域。在此背景下，全球 AI 算力中心等新型基础设施建设迅速增加，推动产业链中 GPU 芯片以及连接器产品的需求增加，从而为公司高速连接器组件产品提供广阔的市场空间。

八、保荐人关于发行人符合创业板上市条件的说明

（一）发行人符合中国证监会规定的创业板发行条件

1. 发行人符合《证券法》规定的发行条件

（1）发行人具备健全且运行良好的组织机构

发行人《公司章程》合法有效，股东会、董事会、审计委员会和独立董事、董事会专门委员会、董事会秘书等制度健全，相关机构和人员能够依法有效履行职责；发行人具有生产经营所需的职能部门且运行良好，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

（2）发行人具有持续经营能力

发行人系依法设立并有效存续的股份有限公司，截至本上市保荐书签署日，发行人的生产经营符合国家产业政策，发行人不存在因违法经营而被相关行政管理部门责令停业整顿或吊销营业执照的情形，不存在根据法律、法规及公司章程规定需要终止的情形。根据中审众环会计师出具的发行人报告期的审计报告等财务资料，发行人主营业务报告期的经营情况等业务资料，发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

（3）发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告

根据中审众环会计师出具的《审计报告》，发行人最近三年财务会计报告被出具标准无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

（4）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪

根据相关政府部门出具的证明文件或企业信用报告（无违法违规证明版），公安部门出具的发行人实际控制人的无犯罪记录证明，并经保荐人审慎核查，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

（5）符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件

经核查，保荐人认为，发行人符合《证券法》及中国证监会规定的关于首次公开发行新股的其他条件，符合《证券法》第十二条第一款第（五）项的规定。

2. 发行人符合《注册办法》规定的发行条件

（1）发行人申请首次公开发行股票符合《注册办法》第三条的规定

发行人申请首次公开发行股票符合《注册办法》第三条关于创业板定位要求的规定，详见本上市保荐书之“七、保荐人关于发行人符合创业板定位及国家产业政策的说明及核查情况”之相关内容。

（2）发行人申请首次公开发行股票符合《注册办法》第十条的规定

保荐人查验了发行人工商档案，发行人改制设立有关内部决策、审计、评估及验资文件，并核查了发行人现行有效的公司章程及报告期内的财务报表及审计报告。发行人系华科有限以股改基准日经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。保荐人认为，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。

发行人已经依法建立健全股东会、董事会、审计委员会以及独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会等制度，相关机构和人员能够依法履行职责。保荐人认为，发行人已经具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

综上，保荐人认为，本次发行符合《注册办法》第十条的规定。

（3）发行人申请首次公开发行股票符合《注册办法》第十一条的规定

经核查发行人的会计记录、记账凭证等资料，结合中审众环会计师出具的标准无保留意见《审计报告》，保荐人认为，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告。

经核查发行人的内部控制制度、内部控制执行记录，结合中审众环会计师出具的《内部控制审计报告》，保荐人认为，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计

师出具了标准无保留结论的内部控制审计报告。

综上，保荐人认为，本次发行符合《注册办法》第十一条的规定。

（4）发行人申请首次公开发行股票符合《注册办法》第十二条的规定

经核查发行人业务经营情况、厂房及设备等主要资产、专利、商标等资料，实地核查有关情况，取得发行人控股股东、实际控制人出具的关于避免同业竞争的承诺，查阅发行人关联交易合同等关联交易相关资料，并结合发行人律师出具的《律师工作报告》和《法律意见书》，以及对发行人董事、原监事和高级管理人员的访谈等资料，保荐人认为，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，本次发行符合《注册办法》第十二条第（一）项的规定。

经核查发行人报告期内的主营业务收入构成、重大销售合同及主要客户、发行人工商档案及股东名册、聘任董事、原监事、高级管理人员的股东会决议和董事会决议、核心技术人员的劳动合同以及访谈文件、发行人控股股东出具的声明和承诺，结合发行人律师出具的《律师工作报告》和《法律意见书》，保荐人认为，发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化，发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近两年实际控制人没有发生变更，本次发行符合《注册办法》第十二条第（二）项的规定。

经核查发行人财产清单、主要资产的权属证明文件、企业信用报告、发行人涉及的诉讼仲裁、行业研究、分析报告等资料，结合与发行人管理层的访谈、中审众环会计师出具的《审计报告》和发行人律师出具的《律师工作报告》和《法律意见书》，保荐人认为，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，本次发行符合《注册办法》第十二条第（三）项的规定。

综上，保荐人认为，本次发行符合《注册办法》第十二条的规定。

（5）发行人申请首次公开发行股票符合《注册办法》第十三条的规定

经核查发行人实际经营情况及开展相关业务所涉及的准入许可及相关资质情况，查阅了与发行人所从事行业相关的国家产业政策，发行人及其控股股东、董事、原监事、高级管理人员出具的声明、承诺及签署的调查表，董事、原监事、高级管理人员提供的无犯罪证明、个人征信报告，取得发行人住所地相关主管政府单位出具的证明文件或企业信用报告（无违法违规证明版），查询中国证监会、证券交易所等监管机构网站及其他公开信息，并结合发行人律师出具的《律师工作报告》和《法律意见书》，保荐人认为，发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策；最近三年，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；发行人董事、原监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年不存在涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。

综上，保荐人认为，本次发行符合《注册办法》第十三条的规定。

因此，发行人符合中国证监会规定的创业板发行条件，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（一）项的规定。

（二）发行人发行后股本总额不低于 3,000 万元

经核查，发行人本次发行前股本总额为 6,857.61 万元人民币，本次公开发行股份不超过 2,310.39 万股，占本次发行后总股本的比例不低于 25%，发行后股本总额不超过 9,168.00 万股。

因此，发行后发行人股本总额不低于 3,000 万元，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（二）项的规定。

（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上

经核查，发行人本次发行前股本总额为 6,857.61 万元人民币，本次公开发行股份不超过 2,310.39 万股，占本次发行后总股本的比例不低于 25%。

因此，本次发行后，公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（三）项的规定。

（四）发行人市值及财务指标符合《创业板上市规则》规定的标准

发行人本次发行上市申请适用《创业板上市规则》第 2.1.2 条第一款第（一）项规定的上市标准：最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元。

根据中审众环会计师出具的《审计报告》（众环审字（2026）0600331 号），发行人最近两年（即 2024 年度和 2025 年度）归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 3,980.13 万元和 10,550.78 万元，满足所选择的上市标准。

（五）发行人符合深圳证券交易所规定的其他上市条件

经核查，发行人符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。

九、保荐人对发行人持续督导工作的安排

主要事项	具体计划
（一）持续督导事项	证券上市当年剩余时间及其后 3 个完整会计年度
1. 督导发行人有效执行并完善防止主要股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度	（1）督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止主要股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度； （2）与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
2. 督导发行人有效执行并完善防止其高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制制度	（1）督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制制度； （2）与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
3. 督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	（1）督导发行人有效执行《公司章程》《关联交易管理制度》等保障关联交易公允性和合规性的制度，履行有关关联交易的信息披露制度； （2）督导发行人及时向保荐人通报将进行的重大关联交易情况，并对关联交易发表意见。
4. 督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	（1）督导发行人严格按照《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务； （2）在发行人发生须进行信息披露的事件后，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件。
5. 持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	（1）督导发行人执行已制定的《募集资金管理制度》等制度，保证募集资金的安全性和专用性； （2）持续关注发行人募集资金的专户储存、投资项目的实施等承诺事项；

主要事项	具体计划
	(3) 如发行人拟变更募集资金及投资项目等承诺事项, 保荐人要求发行人通知或咨询保荐人, 并督导其履行相关信息披露义务。
(二) 保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	(1) 定期或者不定期对发行人进行回访、查阅保荐工作需要的发行人材料; (2) 列席发行人的股东会、董事会和审计委员会; (3) 对有关部门关注的发行人相关事项进行核查, 必要时可聘请相关证券服务机构配合。
(三) 发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定	(1) 发行人已在保荐协议中承诺配合保荐人履行保荐职责, 及时向保荐人提供与本次保荐事项有关的真实、准确、完整的文件; (2) 接受保荐人尽职调查和持续督导的义务, 并提供有关资料或进行配合。
(四) 其他安排	无

十、保荐人对本次发行上市的推荐结论

保荐人认为, 深圳市华科精密工业股份有限公司本次首次公开发行股票并在创业板上市符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所所有规定, 具备在深圳证券交易所创业板上市的条件; 国泰海通证券股份有限公司同意保荐深圳市华科精密工业股份有限公司本次首次公开发行股票并在创业板上市, 并承担保荐人的相应责任。

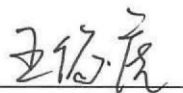
(以下无正文)

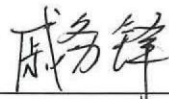
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于深圳市华科精密工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签章页）

项目协办人：


孙振博

保荐代表人：

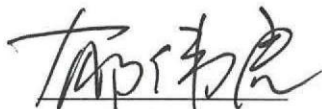

王俊虎


戚务锋

内核负责人：


杨晓涛

保荐业务负责人：


郁伟君

法定代表人（董事长）：


朱 健

